#### BPA MUENCHEN G116 +49 8923994465 7, NOV, 2005 14:22

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM **GEBIET DES PATENTWESENS**

TIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

tel 4 des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens) chen des Anmelders oder Anwalts siehe Formbian PCT/IPEA/416 **WEITERES VORGEHEN** T 45106WO/NZ/ns Prioritatedatum (TagMonatUahr) Internationales Anmeldedatum (TagMonaWahr) Internationales Aktenzeichen 23.07.2003 16.07.2004 PCT/EP2004/007970 Internationale Patentidassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK G06K19/067, G06K19/07 Anmelder OVD KINEGRAM AG et al. Bei diesem Bericht handelt es sich um den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, der von der mit der Internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmeider gemäß 1. Artikel 36 übermittelt wird. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 4 Blätter einschließlich dieses Deckbiatts. 2. Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen 3. (an den Anmelder und das Internationale Büro gesandt) insgesamt 6 Biätter; dabei handelt es sich um Blätter mit der Beschreibung, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit Berichtigungen, denen die Behörde zugestimmt hat (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften). Blätter, die frühere Blätter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1, Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde eine Anderung enthalten, die über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. (nur an das Internationale Büro gesandt) insgesamt (bitte Art und Anzahl der/des elektronischen Datenträger(s) angeben), der/die ein Sequenzprotokoll und/oder die dazugehörigen Tabellen enthältenthalten, nur in computerlesbarer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der Verwaltungsvorschriften). Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten: Grundlage des Bescheids ⊠ Feld Nr. I Priorität ☐ Feld Nr. II Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuhelt, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche ☐ Feld Nr. III Anwendbarkeit Mangeinde Einheitlichkeit der Erfindung ☐ Feld Nr. IV Begründete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung ☑ Feld Nr. V Bestimmte angeführte Unterlagen ☐ Feld Nr. VI Bestimmte Mängel der Internationalen Anmeldung Feld Nr. VII ☐ Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur Internationalen Anmeldung Datum der Fertigstellung dieses Berichts Datum der Einreichung des Antrags 20.09.2005 23.05.2005 Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung Bevollmächtigter Bediensteter

Gronau von, H-C

Tel. +49 89 2399-2276

Europäisches Patentamt

Fax: +49 89 2399 - 4465

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d

D-80298 München

beauftragten Behörde

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/007970

	Feld Nr. I	Grundlage des Berichts
1.	Hinsichtlich eingereicht	der Sprache beruht der Bericht auf der Internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
	bei der Inte Ver Inte	pricht beruht auf einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht worden ist: ernationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) röffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) ernationale vorläufige Prüfung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3)
2.	Hinsichtlich der Bestandtelle* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblätter, die der Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Bericht "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt):	
	Beschreib	ung, Seiten
	1-21	in der ursprünglich eingereichten Fassung
	Ansprüche	·
	1-18	eingegangen am 13.05.2005 mit Schreiben vom 10.05.2008
	Zeichnungen, Blätter	
	1-8	in der ursprünglich eingereichten Fassung
	☐ einer Sequenz	n Sequenzprotokoll und/oder etwalgen dazugehörigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das protokoll
3	□ 8 ⊠ A □ Z	rund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: eschreibung: Seite nsprüche: Nr. 19-22 eichnungen: Blatt/Abb. equenzprotokoli <i>(genaue Angaben)</i> : twalge zum Sequenzprotokoli gehörende Tabellen <i>(genaue Angaben)</i> :
4	aufgeliste Auffassu (Regel 70	seschreibung: Seite Ansprüche: Nr. Zeichnungen: Blatt/Abb. Sequenzprotokoll <i>(genaue Angaben)</i> : Stwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen <i>(genaue Angaben)</i> :
	* Wen "erset	n Punkt 4 zutrifft, können einige oder alle dieser Blätter mit der Bemerkun zt" versehen werden.

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzelchen PCT/EP2004/007970

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkelt und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung Neuhelt (N)

Ja: Ansprüche 1-18

Nein: Ansprüche

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Ja: Ansprüche 1-18

Nein: Ansprüche

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)

: Ansprüche: 1-18

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7): siehe Beiblatt

7. NOV. 2005 14:23

### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT (BEIBLATT)

Internationales Aktenzeichen

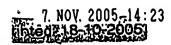
PCT/EP2004/007970

ad V.

1. Es wird auf das folgende Dokument verwieșen:

D1: WO-A-97/21184

- 2. D1, insbesondere Seite 14, Zeile 26 bis Seite 16, Zeile 9, offenbart ein Sicherheitselement 1015 zur RF-Identifikation, wobei das Sicherheitselement eine flexible, elektrisch nicht leitende Substratschicht 1003 und eine auf der Substratschicht aufgebrachte erste elektrisch leitfähige Schicht 1001 aus einem elektrisch leitenden Material aufweist. Die leitfähige Schicht formt ein RF Bauteil (Antenne) und hat eine rillenförmige Reliefstruktur, die in das Substrat eingeprägt worden ist.
- 3. Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von diesem Stand der Technik dadurch, daß die Rillen der Reliefstruktur in der leitfähigen Schicht der Antenne im Mittel mehr längs zur Flußrichtung des elektrischen Stroms als quer zur Flußrichtung orientiert sind, und daß die Reliefstruktur eine Profiltiefe im Bereich von 50nm bis 10µm und eine Spatialfrequenz im Bereich von 100 bis 2000 Linien pro mm aufweist. Die Rillen der Reliefstruktur sind sowohl in der der Substratschicht zugewandten Oberfläche, als auch in der der Substratschicht abgewandten Oberfläche der elektrisch leitenden Schicht ausgebildet. Die Ausrichtung der Rillen auf belden Oberflächen mehr in Längsrichtung bewirkt, daß die effektive Breite der Leiterbahn vergrößert wird. Dazu sind die angegebenen Dimensionen besonders geeignet.
- 4. Diese Kombination von Merkmalen wird durch keines der Verfügbaren Dokumente des Stands der Technik nahegelegt. Der Gegenstand des Anspruchs 1 dürfte daher den Erfordernissen des Artikels 33(2) und (3) PCT genügen. Der unabhängige Anspruch 16 definiert ein entsprechendes Herstellungsverfahren und erfüllt daher ebenso die Erfordernisse des Artikels 33(2) und (3) PCT.
- 5. Die Ansprüche 2-15 und 17-18 sind vom Anspruch 1 bzw. 16 abhängig und erfüllen damit ebenfalls die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit.



25

30



## Neue Patentansprüche

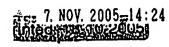
- 1. Sicherheitselement (1, 2, 7, 8) zur RF-Identifikation, wobei das 5 Sicherheitselement eine flexible, elektrisch nicht leitende Substratschicht (11, 24) und eine auf der Substratschicht aufgebrachte erste elektrisch leitfähige Schicht (29) aus einem elektrisch leitenden Material aufweist, die in einem ersten Flächenbereich (4, 51, 53, 63, 64, 65) musterförmig zur Bildung eines RF-Bauteils (12, 72, 81) ausgeformt ist, wobei in dem, dem RF-Bauteil zugeordneten 10 Flächenbereich in der ersten elektrisch leitfähigen Schicht (29) zumindest bereichswelse eine erste Reliefstruktur (27, 28, 60) mit Rillen zur Änderung von elektrischen Eigenschaften des RF-Bauteils abgeformt ist, dadurch gekennzeichnet, daß die erste elektrisch leitfähige Schicht (29) im ersten Flächenbereich (2, 51, 15 53, 63, 64, 65) in Form einer RF-Antenne (12) oder einer Spule ausgeformt ist. daß in dem der RF-Antenne (12) bzw. der Spule zugeordneten Bereich der leitfähigen Schicht (29) die Rillen der Reliefstruktur (27, 28, 60) im Mittel mehr längs zur Flussrichtung des elektrischen Stroms als quer zur Flussrichtung des elektrischen Stroms orientiert sind, und dass die Reliefstruktur (27, 28, 60) eine 20 Profiltiefe im Bereich von 50nm bis 10µm und eine Spatialfrequenz im Bereich von 100 bis 2000 Linien pro mm aufweist, wobei die Rillen der Reliefstruktur (27, 28, 60) sowohl in der, der Substratschicht (11, 24) zugewandten Oberfläche als auch der, der Substratschicht (11, 24) abgewandten Oberfläche der ersten elektrisch leitenden Schicht (29) ausgebildet sind.
  - 2. Sicherheitselement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Substratschicht (24) eine Replizierschicht ist und die erste Reliefstruktur (27) in die der ersten elektrisch leitfähligen Schicht zugewandte Oberfläche der Replizierschicht (27) abgeformt ist.

5

10

15

- 3. Sicherheitselement nach einem der vorhergehenden Ansprüche. dadurch gekennzeichnet, daß die erste elektrisch leitfähige Schicht (29) eine auf die Substratschicht (24) aufgebrachte Metallschicht ist.
- 4. Sicherheitselement nach einem der vorgehenden Ansprüche, dadur.ch gekennzeichnet, daß die erste elektrisch leitfähige Schicht (29) eine Dicke im Bereich von 50 nm bis 50 μm, bevorzugt von 1 bis 10 μm, hat.
- 5. Sicherheitselement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Rillen der Reliefstruktur (27) in dem der RF-Antenne bzw. -Spule zugeordneten Bereich der elektrisch leitfähigen Schicht längs der Flussrichtung des elektrischen Stroms orlentiert sind.
- 6. Sicherheitselement nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die erste elektrisch leitfähige Schicht (29) in dem ersten Flächenbereich (2) in Form ein oder mehrerer Leiterbahnen mit einer Breite von 50 µm bis 10 mm, 20 vorzugsweise 100 µm, ausgeformt ist.
- 7. Sicherheitselement nach einem der vorgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Sicherheitselement eine zweite elektrisch leitfähige Schicht (76) aufwelst 25 und daß im ersten Flächenbereich die erste und die zwelte elektrisch leitfählge Schicht (73, 76) ein kapazitives Element (70) bilden.
- 8. Sicherheltselement nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, 30 daß in dem dem kapazitiven Element (70) zugeordneten Flächenbereich in der zweiten leitfähigen Schicht (76) zumindest bereichsweise eine zweite Reliefstruktur (79) abgeformt ist.



9. Sicherheitselement nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Reliefstruktur (78) eine Vielzahl von sich kreuzenden Rillen aufweist.

5

10. Sicherheitselement nach einem der vorgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Reliefstruktur (27) ein Sägezahn-, Dreieck-, Rechteck- oder Sinusprofil besitzt.

10

11. Optisches Sicherheitselement nach einem der vorgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Reliefstruktur (60) aus der Überlagerung einer Grobstruktur und einer Feinstruktur gebildet ist.

15

- 12. Sicherheitselement nach einem der vorgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Reliefstruktur zusätzlich ein optisches Sicherheitsmerkmal erzeugt.
- 13. Sicherheitselement nach einem der vorgehenden Ansprüche, 20 dadurch gekennzeichnet, daß das Sicherheitselement eine Resonanzschaltung zur RF-Identifikation aufweist.
- 14. Sicherheitselement nach einem der vorgehenden Ansprüche. 25 dadurch gekennzeichnet, daß das Sicherheitselement einen Chip aufweist.
- 15. Sicherheitselement nach einem der vorgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 30 daß das Sicherheitselement ein Folienelement, insbesondere eine Prägefolie, eine Laminierfolie, eine Stickerfolle oder ein Teilelement einer Übertragungslage einer derartigen Folie ist.

4

16. Verfahren zum Erzeugen eines Sicherheitselements zur RF-Identifikation, wobei bei dem Verfahren auf einer flexiblen, elektrisch nicht leitenden Substratschicht (24) in einem ersten Flächenbereich der Substratschicht eine erste leitfählge Schicht (29) aus einem elektrisch leitenden Material musterförmig zur Bildung eines RF-Bautells (12) ausgeformt aufgebracht wird, wobel in dem, dem RF-Bauteil zugeordneten Flächenbereich (2) in der ersten leitfähigen Schicht (29) zumindest bereichsweise eine erste Reliefstruktur (27) mit Rillen zur Änderung von elektrischen Eigenschaften des RF-Bauteils abgeformt wird, wobei die erste elektrisch leitfähige Schicht (29) im ersten Flächenbereich in Form einer RF-Antenne (12) oder einer Spule ausgeformt wird, wobei in dem der RF-Antenne (12) bzw. der Spule zugeordneten Bereich der leitfähigen Schicht (29) die Rillen der Reliefstruktur (27, 28, 60) im Mittel mehr längs zur Fluserichtung des elektrischen Stroms als quer zur Flussrichtung des elektrischen Stroms orientiert werden, und wobei die Reliefstruktur (27, 28, 60) mit einer Profiltiefe im Bereich von 50nm bis 10µm und einer Spatialfrequenz im Bereich von 100 bis 2000 Linien pro mm ausgebildet wird, wobel die Rillen der Rellefstruktur (27, 28, 60) sowohl in der, der Substratschicht (11, 24) zugewandten Oberfläche als auch der, der Substratschicht (11, 24) abgewandten Oberfläche der ersten elektrisch leitenden Schicht (29) ausgebildet werden.

20

25

30

5

10

15

7. NOV. 2005a14:24

17. Verfahren nach Anspruch 16,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
daß die erste leitfähige Schicht (29) vollflächig, insbesondere durch Bedampfung,
auf die Substratschicht aufgebracht wird und dann partiell musterförmig zur
Bildung des RF-Bauteils (12) demetallisiert wird.

18. Verfahren nach Anspruch 16 oder 17,

daß in der ersten leitfähigen Schicht zwei oder mehr mit Verbindungsbahnen verbundene kapazitive Teil-Elemente ausgeformt werden und daß Verbindungsbahnen zu kapazitiven Teil-Elementen später zur Feinabstimmung der Resonanzfrequenz durchtrennt werden.

